

御中

プロダクト／プロセス変更通知書
Product/Process Change Notification (PCN)

件名: MPC8247/8248/8270/8271/8272/8275 PBGA 銅ワイヤボンディング認定

《お願い》

本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2012年7月9日

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社

プロダクトマーケティング本部

該当GPCN番号:

14915

変更内容:

MPC8247/8248/8270/8271/8272/8275製品のPBGA品において、銅ワイヤボンディングを認定いたしました。現在弊社マレーシアKLM工場にて金ワイヤボンディングで認定されている全てのサブストレートサプライヤにおいて、銅ワイヤボンディングの認定をいたしました。組立工場（フリースケールKLM工場）は同一です。外形、FIT、機能、信頼性に影響はありません。

変更理由:

生産性向上

対象製品:

添付別紙の通り。

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日：2012年10月4日

出荷日を特定することはできませんのでご了承ください。

変更品の見分け方:

捺印や外観で見分けることはできませんが、社内のロット管理は行っております。

その他:

【JPCN2012-0131(14915)対象製品】

MPC8270CVRMIBA
MPC8247CVRMIBA
MPC8247CVRPIEA
MPC8247CVRTIEA
MPC8247CZQMIBA
MPC8247CZQPIEA
MPC8247CZQTIEA
MPC8247VRMIBA
MPC8247VRPIEA
MPC8247VRTIEA
MPC8247VRTMFA
MPC8247ZQMIBA
MPC8247ZQTIEA
MPC8248CVRMIBA
MPC8248CVRPIEA
MPC8248CVRTIEA
MPC8248CZQMIBA
MPC8248CZQPIEA
MPC8248CZQTIEA
MPC8248VRMIBA
MPC8248VRPIEA
MPC8248VRTIEA
MPC8248VRTMFA
MPC8248ZQMIBA
MPC8248ZQPIEA
MPC8248ZQTIEA
MPC8270CZQMIBA
MPC8270VRMIBA
MPC8270ZQMIBA
MPC8271CVRMIBA
MPC8271CVRTIEA
MPC8271CZQTIEA
MPC8271VRMIBA
MPC8271VRPIEA
MPC8271VRTIEA
MPC8271ZQMIBA
MPC8271ZQTIEA
MPC8272CVRMIBA
MPC8272CVRTIEA
MPC8272CZQMIBA
MPC8272CZQTIEA
MPC8272VRMIBA
MPC8272VRPIEA
MPC8272VRTIEA
MPC8272VRTMFA
MPC8272ZQMIBA
MPC8272ZQTIEA
MPC8275CVRMIBA
MPC8275CZQMIBA
MPC8275VRMIBA
MPC8275ZQMIBA
SC41008A
SC41013
SC41015
SC41017
SC411207A
SC8275CZQPHDA
SC8275VRPHDA